GTC 大会引领铜互联变革

2024 年 03 月 25 日

市场回顾

本周（3 月 18 日-3 月 22 日）电子板块涨跌幅为 1.48%，相对沪深 300 指数涨跌幅+2.18pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为半导体设备 6.51%，消费电子组件 5.18%，其他电子零组件Ⅲ 5.01%，PCB 1.64%，显示零组 1.08%，半导体材料 0.90%，LED 0.27%，集成电路 0.19%，分立器件-0.95%，安防-1.71%，被动元件-2.15%，消费电子设备-2.81%，面板-3.07%。

行业要闻

1、**GB200 发布，重视铜互联产业链投资机遇。**2024 年 3 月 18 日，英伟达 2024 年 GTC 大会开幕。此次大会上，黄仁勋发表了主题演讲《见证 AI 的变革时刻》，发布新产品 GB200 有望成为一款走量产品，其 GPU 内部连接采用铜缆的技术方案，相关供应链有望伴随其迎来放量机遇。

2、**AMD+微软盛会，巨头加码 AI PC。**AMD 于 2024 年 3 月 21 日在北京召开“AMD AI PC 创新峰会“，AMD CEO Lisa Su 及公司高层，以及产业链合作伙伴共同出席峰会，展示了 AMD 在 AI PC 的最新布局。3 月 22 日微软举办“办公新时代”新品发布会，推出两款全新的 AI PC 产品并展示了 Window AI 助手—Copilot 的系列功能。

3、**SEMICON 行情火爆，半导体设备投资景气高企。**SEMICON China 大会于 3 月 20 日-3 月 22 日在上海举办，本次展会约有 1100 家展商，4500 个展位，参展厂商覆盖半导体设计、制造、封装、测试、设备、材料以及关键零部件等全产业链，规模空前，彰显半导体产业投资高景气。

4、**台积电扩产 CoWoS 先进封装，把握盛合晶微产业链投资机遇。**据中国台湾《经济日报》报道，台积电将在嘉义科学园区先进封装厂新厂加大投资，总投资额逾 5000 亿台币（约合 1137 亿人民币），主要扩充 CoWoS 先进封装产能，预计 4 月上旬对外公布。

5、**荷兰首相拟访华，ASML 光刻机供应持续高增。**3 月 23 日，路透社报道，荷兰首相马克吕特将于下周会见习近平主席，双方将就 ASML 数十亿欧元光刻机订单的供应许可展开洽谈。

6、**翔港科技投资金泰克，涉足存储市场。**3 月 21 日，翔港科技公告，公司计划以自有或自筹资金 1.5 亿元认购深圳市金泰克半导体有限公司，本次交易完成后，公司持有金泰克 10%股权，金泰克成为公司的参股公司。

本周观点：站在当下，AI 是最核心的投资方向，从云到端的变革汹涌，GTC 的铜互联方案为未来的云架构指明方向；以 COWOS、HBM 为代表的先进封装，有望接力国产替代，成为下一阶段投资重点；存储则周期成长兼备，重视切入企业级存储的龙头公司。

AI 算力：供给侧看先进封装，核心关注：长川科技、精智达、通富微电、兴森科技、赛腾股份。需求侧关注铜互联赛道：沃尔核材、博威合金、鼎通科技、立讯精密、鸿腾精密、新亚电子、华丰科技。

存储链：业绩弹性关注德明利、江波龙；长鑫链关注雅克科技、华特气体、北方华创、中微公司；HBM 方面，除了前文提及的通富微电、赛腾股份、精智达外，还可关注 TCB 龙头设备厂商 ASMPT。

风险提示：电子行业周期复苏不及预期；行业竞争加剧；汇率波动。

推荐

维持评级



分析师 方竞
执业证书：S0100521120004
邮箱：fangjing@mszq.com

分析师 李少青
执业证书：S0100522010001
邮箱：lishaoqing@mszq.com

分析师 童秋涛
执业证书：S0100522090008
邮箱：tongqiutao@mszq.com

分析师 李萌
执业证书：S0100522080001
邮箱：limeng@mszq.com

研究助理 张文雨
执业证书：S0100123030013
邮箱：zhangwenyu@mszq.com

相关研究

1.电子行业点评：苹果与谷歌的碰撞，AI 手机新机遇-2024/03/19

2.电子行业周报：展望 GTC 变革，共享 AI 盛宴-2024/03/17

3.电子行业点评：景宏系列产品研发成功，景嘉微国产算力再进一步-2024/03/13

4.可控核聚变行业点评：超导磁体突破，可控核聚变进程加速-2024/03/12

5.电子行业周报：HBM+大模型+AI PC，从云到端的 AI 革命-2024/03/11

目录

1 本周观点 3
1.1 GB200 发布，重视铜互联产业链投资机遇 3
1.2 AMD+微软盛会，巨头加码 AI PC 7
1.3 SEMICON 行情火爆，半导体设备投资景气高企 11
1.4 台积电扩产 CoWoS 先进封装，把握盛合晶微产业链投资机遇 12
1.5 荷兰首相拟访华，ASML 光刻机供应持续高增 15
1.6 翔港科技投资金泰克，涉足存储市场 16
2 公司新闻 18
3 市场行情回顾 21
4 风险提示 23
插图目录 24
表格目录 24

1 本周观点

1.1 GB200 发布，重视铜互联产业链投资机遇

2024 年 3 月 18 日，英伟达 2024 年 GTC 大会开幕。此次大会上，黄仁勋发表了主题演讲《见证 AI 的变革时刻》，核心内容包括：1）推出新一代 Blackwell GPU 平台，发布 GB200 芯片，相较 H100 最高提供 30 倍的性能提升；2）宣布 GR00T 项目，推动英伟达在机器人和具身智能领域的进展；3）发布了 AI 微服务 NIM，用于开发和布局企业级 AI 应用；4）宣布为苹果 Vision Pro 提供 Omniverse 计算平台；5）展示了下一代数据中心蓝图以及全新的 6G 云平台 AI 技术等。

1.1.1 GB200 采用全新架构，性能大幅提升

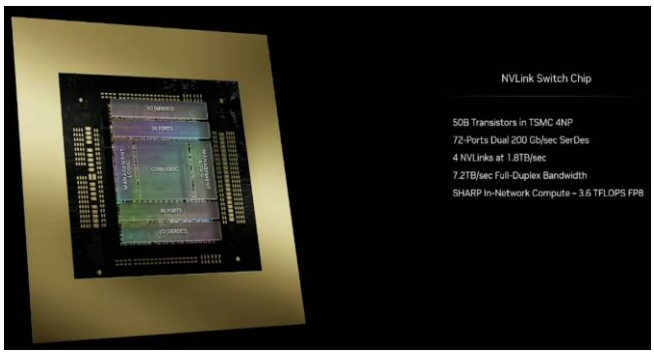
英伟达发布全新 Blackwell 架构 GPU，GB200 推理算力达到 40PFlops。在此次 GTC 大会上，英伟达发布了全新的 Blackwell 架构 GPU，该芯片采用台积电 4NP 工艺，由两颗 die 组成，die 与 die 之间片间互联速度达到 10TB/s，Blackwell GPU 的 FP4 算力达到 20PFlops，拥有 192GB HBM3e，内存带宽为 8TB/s。GB200 芯片由两颗 B200 Blackwell GPU 和一颗 Grace CPU 组成，FP8 和 FP4 算力分别达到 20PFlops 和 40PFlops。

图 1：GB200 芯片参数



资料来源：英伟达，民生证券研究院

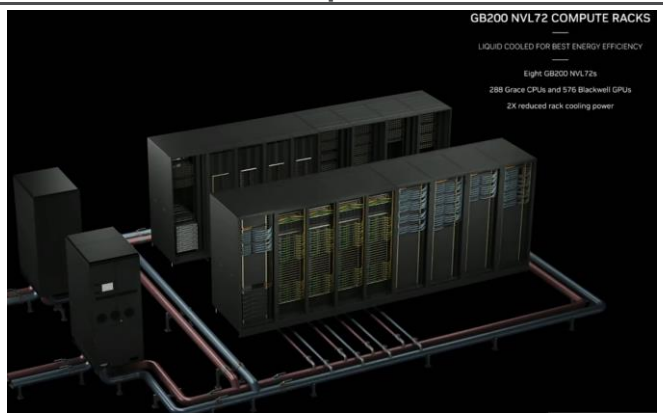
图 2：英伟达新一代 NV Switch 芯片参数



资料来源：英伟达，民生证券研究院

GB200 NVL72 采用全新架构，单个 NVL72 拥有 72 颗 GPU，36 颗 CPU 和 18 颗 NV Switch。英伟达的 GB200 系统的 NVLink 域支持 36 个和 72 个 GPU，NVL36 的版本的 GPU 数量为 NVL72 版本的一半。一个 GB200 NVL72 compute Rack 拥有 8 个 GB200 NVL72，288 颗 Grace CPU 和 576 颗 Blackwell GPU，整个数据中心集群将拥有 32000 颗 GPU，645EFLops AI 算力 13PB 高速内存和累计 58PB/s 的 NVLink 互联带宽。

图 3：GB200 NVL72 compute Rack 架构



资料来源：英伟达，民生证券研究院

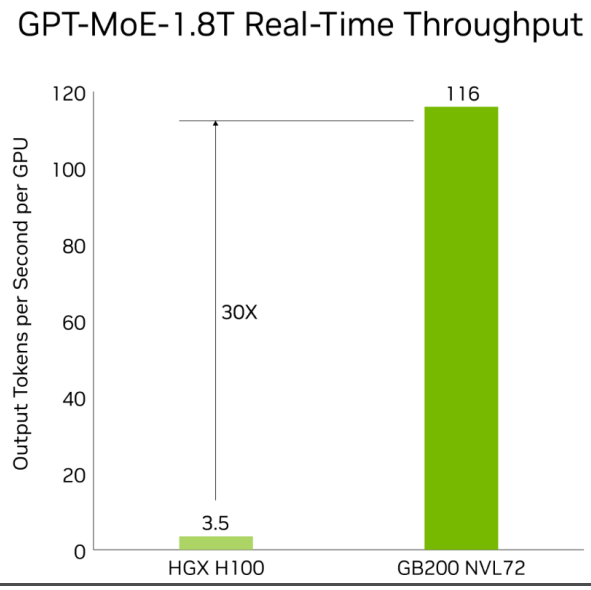
图 4：GB200 数据中心架构



资料来源：英伟达，民生证券研究院

NVLink 互联速度升级到 1.8TB/s 双向带宽，集群性能更优。此次英伟达在 GTC 大会上推出了全新的 NV Switch 芯片，拥有 1.8TB/s 双向带宽，相较上一代 NVLink 提升了一倍，可以支持 576 块 GPU 之间的高速通信。从集群运算性能来看，GB200 引入了先进的功能和第二代 Transformer 引擎，可加速 LLM 推理工作负载，相较于相同数量的 H100，GB200 NVL72 最高可以提供 30 倍的性能提升，同时成本和能耗最低可以下降至 1/25。

图 5：与 H100 相比，GB200 可以提供 30 倍的实时吞吐量



资料来源：英伟达，民生证券研究院

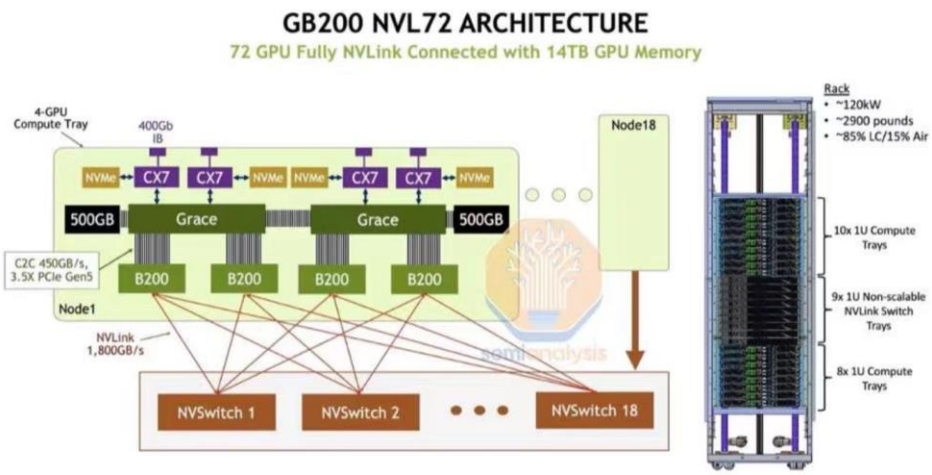
1.1.2 “光铜并进”，重视高速铜缆产业链

英伟达新一代 AI 芯片引领高速线缆市场。英伟达 CEO 黄仁勋发布最新一代 AI 芯片架构 Blackwell，首款 Blackwell 芯片 GB200 采用铜缆连接成为一大亮点。GB200NVLink Switch 和 Spine 由 72 个 Blackwell GPU 采用 NVLink 全互连，具有 5000 根 NVLink 铜缆（合计长度超 2 英里）。英伟达官网显示，NVIDIA®

Mellanox® LinkX® InfiniBand DAC 铜缆是在 InfiniBand 交换网络和 NVIDIAGPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟 100G/EDR、200G/HDR 和 400G/NDR 链路的成本最低的方式。

对比 GH200，GB200 把交换机、服务器和 GPU 集成在同一个机柜内，改用了刀片式服务器的连接连接方式，采用背板线缆模式，这种模式提高了散热效率、改善服务器与交换机的信号传输质量。

图 6：GB200NVL72 架构



资料来源：英伟达，民生证券研究院

英伟达新产品 GB200 有望成为一款走量产品，其 GPU 内部连接采用的铜缆的技术方案，相关供应链有望伴随其迎来放量机遇。目前该领域以海外龙头为主，国内正加速布局，目前已经有多家公司的产品投入使用：

立讯精密：铜连接一直是立讯通讯业务的核心产品。公司在铜缆连接方面已基于自主研发的 Optamaxm 散装电缆技术，开发了 112G PAM4 无源铜缆(DAC)、112G PAM4 有源铜缆(ACC)，通过将 Optamaxm 超低损耗高速裸线以符合 MSA 标准的 paddle card 和 cage 技术，将八个通道组合在一起，以每通道高达 112 Gbps 的速度运行到一个高密度数据接口（MDI）中，并与 Marvell 的 DSP 芯片结合，可以提供超过 800 Gbps 的聚合数据吞吐量。借助这项技术，公司实现了在铜物理特性方面的突破，把铜缆的应用长度进一步延长到 5m，满足数据中心柜内及柜间的铜缆应用拓展需求，而这正是当下在短距（小于 5m）传输中替代光模块最具性价比的方案。公司已与惠普、思科等海外四大云厂商，及华为、浪潮等国内头部公司开展合作。

沃尔核材：国内高速通信线缆龙头，子公司乐庭智联生产的高速通信线主要应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的数据信号传输。产品类别主要包括 SAS3.0/4.0/5.0、PCIe4.0/5.0、10G/40GQSFP+、25G/100GQSFP28、400GDD、QSFP56 等。目前，400G 高速通信线已实现稳定量产，应用于多个高速通信项目；800G 高速通信线已完成产品开发，部分规格已通过客户验证并实现

小批量交付。公司高速通信线主要客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科等。

鼎通科技：公司的高速通讯连接器及其组件主要包括高速背板连接器组件和 I/O 连接器组件，通过工艺结构分为：**精密结构件和壳体（CAGE）等，是通讯连接器模块组成部分，最终应用于服务器、数据中心、基站等大型数据存储和交换设备。**目前 I/O 连接器及其组件已研发至 QSFP 112G 系列，目前正在逐渐小批量试产中。**客户方面，与安费诺、莫仕、泰科电子等深度绑定。**

博威合金：信号传输的高速连接器等材料是信号交换的核心材料，公司的高强高导为代表的特殊合金材料在先进封装所用的 Socket 基座、数据交换高速连接器及散热器件等场景有广泛应用，公司的直接客户是全球知名连接器厂商，并已合作多年。

鸿腾精密：公司布局 EV 电动车、5G AIOT 人工智能物联网、Audio 音讯三大关键产业以及铜到光、有线到无线、元件到系统三大技术。公司于今年 DesignCon 推出 224G 高速 I/O 系列产品，此外，公司也发展出优秀的铜连接解决方案，特别是在晶片中心架构中，包括共同封装解决方案、近晶片连接器和 224G 内部电缆到 IO 等家族系列产品。

新亚电子：公司司高频数据线材主要应用于服务器存储系统中主板与背板、主板与硬盘的链接，**目前通过安费诺给浪潮、惠普和戴尔等大数据服务器头部制造商提供优质高频数据线。**

华丰科技：公司在通讯领域提供高速背板连接器，以及电源类连接器、射频类连接器以及光通讯连接器等传统的通讯连接器。其中高速线模组是将高速背板连接器和高速线缆整合成组件，再将组件和其他的线缆整合，形成一个完整的连接网络的形式，技术难度较高；目前主要应用于高端服务器、交换机、超级计算机等领域，下游客户包括华为外、中兴通讯、诺基亚、烽火通信、新华三等通讯设备厂商。

兆龙互连：目前公司已能够规模化生产应用于传输速率达到 400Gbps 的高速传输电缆及组件；800G 高速组件产品已经开发成功，于重点客户送样认证中，DAC 产品已在数据中心中广泛应用。公司高速电缆及组件产品已广泛应用于互联网企业、服务器厂商的数据中心、云计算领域，将进一步拓展客户。

金信诺：公司的高速产品目前主要应用于交换机/服务器内部板卡、存储等内部连接，以及超算组网链路、TOR 与服务器之间的外部连接。**目前高速业务 90%应用于服务器内部的高速连接产品，AOC 及 DAC 产品为外部连接产品。**800G 方面，目前已成功研发 800G 系列裸线和 QDD800 系列组件，同时也在开发 800G 其它系列的连接产品，但现阶段 800G 产品需求主要为海外客户，暂未实现销售。

联想集团：GTC 大会期间，联想集团与 NVIDIA 宣布合作推出全新混合人工智能解决方案，**并展示了全新的 PG8A0N，这是一款终极 1U 节点，支持 NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip。**GB200 功耗增大，液冷系统成为标配，

根据智通财经，**联想集团在实现高效能和高功耗计算方面处于领先地位，多年前便推出了创新的联想海王星液冷技术，该技术使联想在 Green500 榜单上排名第一，**并且其尖端设计得到了 NVIDIA GPU 支持，能够提高计算速度，并确保在高温和多 GPU 环境下也能维持设备的冷却。**此外联想 ThinkSystem 品牌亦推出支持 H100、H200 以及 B200 的相关产品。**

1.2 AMD+微软盛会，巨头加码 AI PC

1.2.1 AI 重塑 PC，AMD 展示从硬件到生态全方位布局

AMD 于 2024 年 3 月 21 日在北京召开“AMD AI PC 创新峰会“，AMD CEO Lisa Su 及公司高层，以及产业链合作伙伴共同出席峰会，展示了 AMD 在 AI PC 的最新布局。

Lisa Su 认为从数据中心到边缘计算再到 AI PC，AI 革命正在重塑科技行业，AI PC 成为用户与 AI 互动的重要工具，可以使用户获得个性化的 AI 体验。AMD 在峰会上展示了其在 AI PC 硬件及生态的全方位布局：

AI 硬件：AMD 在 PC 侧重点布局三种计算引擎：基于**“Zen”架构**的 CPU，基于 **RDNA** 的集成或独立 GPU，以及基于 **XDNA** 的 AI 引擎，即 NPU。其中 NPU 为针对 AI PC 推出的全新计算引擎，也是 AI PC 区别与传统 PC 的主要特征之一，其所使用的 XDNA 为一种自适应数据流架构，为 AMD 通过收购 Xilinx 实现。**基于 XDNA 架构的 NPU 首次搭载于 2Q23 发布的 AMD 7040 系列处理器，可提供 10TOPS AI 算力，**已在 Camera 应用里可支持自动画幅（Automatic Framing）、目光接触（Eye Contact）、背景特效(Background Effects)等 AI 功能。

23 年底 AMD 进一步推出锐龙 8040 系列处理器，CPU/GPU/NPU 分别对应 Zen 4/RDNA 3/XDNA 的构架，其中 Zen 4 在 Int 8 整数推理上拥有 85%的提升，且支持 FP32；RDNA3 的 AI 加速器的数量提升两倍，AI 性能提升了 1.85 倍；NPU 性能升级至 16TOPS，相较上代提高 60%。**AMD 计划在 24 年内推出”Strix Point“处理器，该处理器将采用全新 XDNA 2 架构，将 NPU 计算和代际的 AI TOP 算力提升至上代的 3 倍。**

图 7：AMD 针对 AI 不同应用场景布局的几类架构



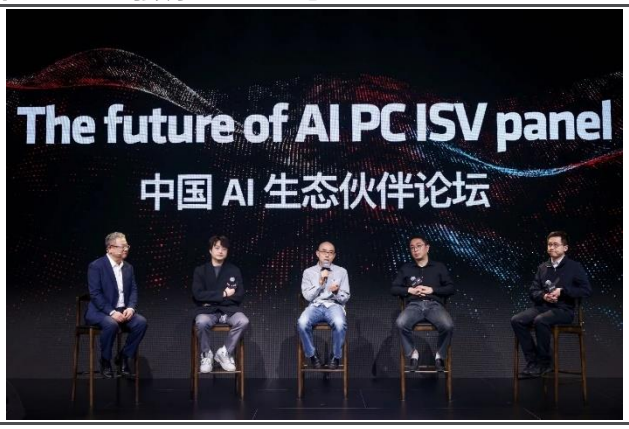
资料来源：AMD 官方公众号，民生证券研究院

AI 生态：AMD 在硬件之外，持续布局开放的端到端的软件生态系统。**AMD 提供了 Ryzen AI 软件，**利用编译器等后端工具，将 CPU、GPU 和 NPU 的算力统一，使开发者能够利用选择的 AMD Ryzen AI 处理器中集成的 AMD XDNA 架构的全部潜力。该软件优化了 AI 任务和工作负载，释放 CPU 和 GPU 资源，以较低功耗实现更好的性能，使 ISV（Independent Software Vendors ，独立软件开发商）合作伙伴能够利用数千个 AI 模型。**到 2024 年底，AMD 计划推动超过 150 个 ISV 为 Ryzen AI 进行开发。**

始智 AI CEO 刘道全在峰会发表演讲，**提出未来在 To B 场景，60%以上的大模型应用或将基于开源大模型开发，**当前始智已经建立开源基础模型开源社区，打通开源模型资源—底层算力—大模型应用之间通道，促进开源模型基于平台的应用开发。将于

合作伙伴：联想集团副总裁兼中国区总裁刘军发表演讲，提到联想**搭载端侧模型的 AI PC 新品将于 4 月 18 日的联想创新科技大会上正式发布，**并利用搭载 AMD 处理器的联想 AI PC 向 Lisa Su 现场生成一张配有 AI 牡丹花邀请函。华硕电脑全球副总裁石文宏亦提到华硕正利用 AMD 平台推进 AI PC 软硬件生态和产品矩阵。

图 8：AMD 强调 AI PC 生态



资料来源：AMD 官方公众号，民生证券研究院

图 9：AMD 与联想共同打造 AI PC



资料来源：AMD AIPC 创新峰会，民生证券研究院

1.2.2 微软推出 Surface 新品，展示 Copilot 功能

3 月 22 日微软举办“办公新时代”新品发布会，推出两款全新的 AI PC 产品：Surface Pro 10 商用版和 Surface Laptop 6 商用版，两款产品提供了更优秀的性能、续航、接口、屏幕素质、耐用性等，具备商用客户关注的各种功能。此外，发布会还展示了 Window AI 助手—Copilot 的系列功能。

Surface Pro 10 商用版为平板/PC 二合一产品，采用英特尔酷睿 Ultra 处理器，性能较上代提高 50%，支持键盘、触屏、触控笔、语音等多种交互方式，屏幕方面采用定制化防反射涂层，具备更好的显示体验。针对远程会议场景，Surface Pro 10 商用版配备了全新的超广角镜头，成为首款具有 114 度超广角视野的 Windows PC，能够以 1440p 的分辨率进行拍摄，**其还可以借助由 AI 支持的 Windows Studio Effects 始终保持发言人在画面的中心位置，**保持较好视频通话状态。该产品当前已上架，售价 9888 元起。

Surface Laptop 6 商用版为笔电产品，搭载了英特尔酷睿 Ultra H 系列处理器，性能相较上一代产品翻倍。该产品同样搭载触摸屏并支持防反射功能，支持 AI 驱动的 Windows Studio Effects 功能。该产品当前已上架，售价 12288 元起。

图 10：Surface Pro 10 商用版



资料来源：微软官方公众号，民生证券研究院

图 11：Surface Laptop6 商用版 (红框为 Copilot 键)



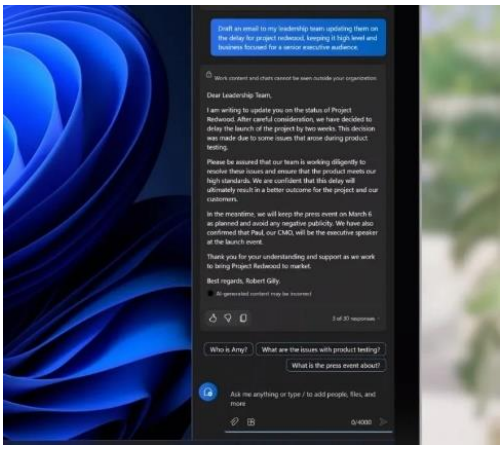
资料来源：微软官方公众号，民生证券研究院

两款产品均在 AI 功能上进行了适配，**如两款电脑均支持全新的键盘布局，在方向键左侧加入单独的 Copilot 键，以实现对 Copilot AI 功能更快的调用**；两款产品均支持 AI 驱动的 Windows Studio Effects 功能以及实时字幕功能，**这些功能由 NPU 提供算力而不占用 CPU 和 GPU 算力，保证系统高效运行。**

微软在发布会上还展示了 Copilot 在办公等领域的系列功能，用户可指示 Copilot 从邮箱里找特定工作内容以及总结重点，并可利用 Copilot 生成邮件回复。用户可输入文字让 Copilot 执行系统指令，如指示 Copilot 更改桌面壁纸、清理存储空间、打开省电模式等。

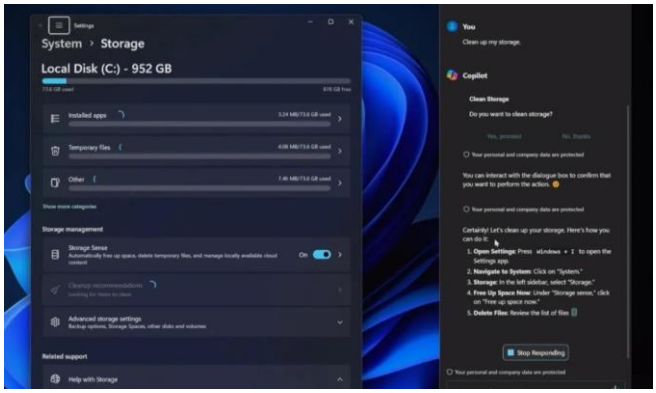
Copilot 当前已具备对用户操作习惯的记忆功能，如用户喜欢将某几个窗口并排呈现以方便操作，下次用户可直接指示 Copilot 帮忙整理窗口，Copilot 将直接按照用户历史上窗口同屏排布的习惯来执行，**体现出 AI PC 个性化、定制化优势。微软副总裁 Jared Spataro 提到 Copilot 可帮助用户每月节省超过 10 个小时的时间，**68%的用户表示 Copilot 提高了工作质量，70%的用户表示提高了工作效率，有 77%的用户不愿停止使用 Copilot。

图 12：Copilot 生成邮件回复



资料来源：智东西，民生证券研究院

图 13：Copilot 帮助清理存储空间



资料来源：智东西，民生证券研究院

1.3 SEMICON 行情火爆，半导体设备投资景气高企

1.3.1 SEMICON 规模盛大，国产设备新品频发

SEMICON China 大会于 3 月 20 日-3 月 22 日在上海举办，本次展会约有 1100 家展商，4500 个展位，参展厂商覆盖半导体设计、制造、封装、测试、设备、材料以及关键零部件等全产业链，规模空前，彰显半导体产业投资高景气。

本次 SEMICON 诸多国产半导体设备厂商新品频发：

芯源微发布化学清洗机 KSCM300 和 SiC 划片裂片一体机 KS-S200-2S1B；

芯碁微装发布 8 英寸晶圆对准和晶圆键合机，可用于阳极键合、热压键合等封装工艺；

此外还有北方华创、中微公司、拓荆科技、微导纳米、上海精测、凯世通、京仪装备、正帆科技、新莱应材、富创精密、英杰电气、华峰测控、长川科技等诸多国产设备厂商参展。

1.3.2 海外设备厂商云集，看多国产半导体投资景气

除国产厂商以外，本次展会诸多海外设备龙头厂商积极参展，看多国内半导体设备投资景气。

前道制程方面，美国**应用材料**（AMAT）作为展会赞助商为中国客户举办说明会，美国**科磊**（KLA），日本**东京电子**（TEL）、**斯库林**集团（SCREEN）参展。

后道先进封装方面，**库里索法**半导体（K&S）展示多种点胶、焊线设备；**ASMPT** 展示高精度固晶设备。

海外厂商的高度重视，主要得益于近两年中国市场需求持续高企，引领全球半导体设备投资。SEMI 全球副总裁居龙在 SEMICON 发布会上表示，由于中国半导体设备市场超预期的强劲表现，SEMI 对于全球半导体设备市场的预测由最初的“2023 年将有 10%-14%的负增长”调整为“2023 年将略微收缩 2%达到 1000 亿美元”。**SEMI 预计，2024 年全球半导体市场将会约有 10%的同比上升，全球半导体晶圆产能将在 2024 年增长 6.4%，而 2025 年全球半导体设备总销售额将达到 1240 亿美元的新高。**

前期，全球光刻机龙头 ASML 亦在 23Q4 法说会上表达对中国市场需求的乐观展望，2023 年 ASML 中国大陆业务收入同比增长 149%，ASML 表示 2024 年中国市场中等先进制程（mid-critical nodes）和成熟制程光刻机需求仍持续强劲。

产业层面高度看好中国大陆设备投资景气度，我们建议重视国产半导体设备

板块投资机遇，建议关注：前道制程设备**北方华创、中微公司、拓荆科技**等；后道先进封装设备 **ASMPT、芯碁微装**等；设备零部件**正帆科技、英杰电气**等。

1.4 台积电扩产 CoWoS 先进封装，把握盛合晶微产业链投资机遇

台积电大力投资 CoWoS 封装，引动新一波供应链拉货潮。随着人工智能的蓬勃发展，全球对先进半导体封装的需求激增。AI 芯片除了对工艺制程要求较高之外，也带动了对 CoWoS 先进封装需求的不断增长。目前，全球 CoWoS 产能仍短缺，影响包括英伟达在内的大厂 AI 芯片出货进度。据中国台湾《经济日报》报道，台积电将在嘉义科学园区先进封装厂新厂加大投资，园区将拨出六座新厂用地给台积电，比原本预期的四座多两座，总投资额逾 5000 亿台币（约合 1137 亿人民币），主要扩充 CoWoS 先进封装产能，相关环评、水电设施都已盘点、处理完成，预计 4 月上旬对外公布。台积电首席执行官魏哲家也曾在 1 月份表示，该公司计划今年将 CoWos 产量增加一倍，并计划在 2025 年进一步增加，我们认为此轮投资预计引动新一波供应链拉货潮。

盛合晶微拟科创板 IPO，把握产业链投资机遇。2023 年 6 月 28 日，据证监会披露，中金公司发布了关于 SJ Semiconductor Corporation（以下简称“盛合晶微”）首次公开发行股票并上市辅导备案报告。盛合晶微，是全球首家采用集成电路前段芯片制造体系和标准，采用独立专业代工模式服务全球客户的中段硅片制造企业。公司的 12 英寸高密度凸块（Bumping）加工、12 英寸硅片级尺寸封装（WLCSP）和测试（Testing）达到世界一流水平，服务于国内外领先的芯片企业，成为硅片级先进封装测试企业标杆。我们认为公司募资扩产之后将会为国产先进封装供应链带来显著的投资机遇。

封测设备方面：高端封测设备国产化加速。高端封测设备当前仍由海外厂商占据主要市场，测试机领域，据华经研究院 2021 年数据，泰瑞达（美国）、爱德万（日本）分别有 51%和 33%的全球市场份额，分别在存储测试机和 SOC 测试机领域占据优势；封装设备领域则由 ASMPT（新加坡）和 K&S（美国）占有较大市场份额。建议关注：

ASMPT：全球固晶设备龙头，专注表面贴装技术。据 yole 数据，2018 年全球固晶设备市场 ASMPT 以 31%份额位列第一。2023 年全年，公司先进封装设备业务收入达 4.1 亿美元，占公司总营收 22%，其中，TCB 设备、FC 设备、HB 设备是三大成长方向。**1）TCB 方面**，拥有全球最大装机量，客服覆盖 HBM 晶圆厂及 OSAT 封测厂，下游可运用于 HBM 堆叠和算力芯片 C2S/C2W 封装环节，已拥有面向下一代 12H/16H HBM 的 TCB 设备。**2）FC 固晶机方面**，高精度固晶设备同样可用于 HBM 和算力芯片的 C2W 封装及 C2S 封装；**3）HB 方面**，2023 年

HB 设备获得首批订单，并正在与存储客户合作开发下一代 HB 产品。

长川科技：产品覆盖分选机、探针台、AOI 光学检测设备等，2023 年完成对长奕科技的收购，巩固分选机产品线。同时公司进一步开拓了探针台、数字测试机等新产品线，开发了高速高性能 SoC 芯片专用测试系统。

精智达：主业为新型显示器件检测设备，广泛应用于 AMOLED 等下游市场。外延拓展存储测试设备产品，进展顺利，DRAM 晶圆老化测试设备进入验证阶段，DRAM 测试机处于测试阶段，探针卡进入批量交付阶段，同时积极布局了 HBM 相关晶圆测试设备及探针卡开发。

芯碁微装：国产直写光刻设备龙头，产品用于泛半导体和 PCB 制造。在先进封装领域，公司 WLP 系列产品可用于 8/12 寸封装，包括 Flip Chip、Fan-InWLP、Fan-OutWLP 和 2.5D/3D 等先进封装形式。在 IC 载板领域，公司产品技术指标比肩国际龙头厂商。2024 年 3 月公司在 SEMICON 发布晶圆对准和晶圆键合设备加码先进封装市场。

芯源微：在先进封装领域拥有涂胶显影设备和单片湿法设备产品线，2023 年批量销售超百台套，近年来已作为主流机型批量应用于台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、中芯绍兴、中芯宁波等国内一线大厂，已经成为客户端的主力量产设备，并持续加深与盛合晶微、长电绍兴等国内先进封装厂商的合作。同时，公司重视算力芯片 Chiplet 工艺前景，开发了临时键合、解键合设备，处于客户验证中。

封装材料方面：高端芯片国产替代先锋，先进材料国产化迫在眉睫。先进封装所呈现出轻薄化、高集成度等特点对材料提出了更高的性能要求，日本、美国厂商在中高端产品占有较大份额，材料国产化提速之下，具备前瞻性的技术布局的内资厂商将有望在未来的竞争中脱颖而出。

兴森科技：公司是国内领先的 FCBGA 封装基板厂商，截至 2023 年底公司珠海 FCBGA 封装基板项目部分大客户的技术评级、体系认证、可靠性验证均已通过，预计 2024 年第一季度进入小批量生产阶段，目前已有少量样品订单收入，金额较小；广州 FCBGA 封装基板项目设备安装调试已基本完成，已进入内部制程测试阶段。

强力新材：公司光刻胶专用电子化学品，包括光刻胶用光引发剂、光增感剂、活性稀释剂、光刻胶树脂（及配套单体）；绿色光固化材料，包括自由基与阳离子两大光固化体系的引发剂、活性稀释剂、光敏树脂等。公司主要客户包括长兴化学、旭化成、昭和电工、住友化学、JSR、TOK、三菱化学、LGC、三星 SDI 等全球知名光刻胶生产商。在先进封装领域，公司研发生产的光敏性聚酰亚胺是作为再布线层材料广泛应用于先进封装中，目前公司的光敏性聚酰亚胺处于下游客户验证阶段。公司的光敏性聚酰亚胺是自主开发的产品，在研发团队，研发评价平台，量产化平台，原材料供应方面拥有一定优势。

艾森股份：公司以传统封装电镀系列化学品起步,经过多年努力,于 2016 年起逐步取代国外材料公司成为传统封装电镀化学品领域的国内主力供应商,并于 2018 年开始逐步向先进封装、晶圆制造及显示面板等领域延伸,形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大业务板块。2022 年度，公司先进封装领域收入为 6,581 万元，占公司营业总收入 3.19 亿元的 20.62%，其中电镀液及配套试剂 772 万元，占比 11.74%，光刻胶及配套试剂 5,774 万元，占比 87.75%。先进封装电镀方面：先进封装用电镀铜基液（高纯硫酸铜）已在华天科技正式供应；先进封装用电镀锡银添加剂已通过长电科技的认证，尚待终端客户认证；先进封装用电镀铜添加剂正处于研发及认证阶段。先进封装光刻方面：先进封装用 g/i 线负性光刻胶已通过长电科技、华天科技的认证并实现批量供应；光刻胶配套试剂如附着力促进剂、显影液、去除剂、蚀刻液等产品在下游封装厂商的规模化供应。公司铜蚀刻液产品主要客户包括盛合晶微，2022 年度销售收入约 232 万元，另外，公司先进封装用 g/i 线负性光刻胶（bumping）在盛合晶微测试认证中。

天承科技：公司是我国最早从事电子电路功能性湿电子化学品研究和生产的企业之一，积累了一批优质的客户，包括东山精密、深南电路、方正科技、景旺电子、崇达技术、兴森科技、定颖电子、世运电路、生益电子、博敏电子、中京电子、奥特斯、华通电脑、信泰电子、南亚电路等知名企业。公司通过自身过硬的配方研发和改良升级能力，已实现高端电子电路用水平沉铜专用化学品和电镀专用化学品的部分国产替代，解决了关键的“卡脖子”技术，实现了自身收入和业绩的快速增长。先进封装部分，公司 RDL、bumping 相关的基础液和电镀添加剂已经研发完成。其中，RDL 应用的基础液和电镀添加剂已经进入了终端客户最终验证阶段，此外，TSV 电镀添加剂和晶圆级电镀大马士革电镀液产品的研发进程正处于全力推动中。上海工厂二期半导体项目建设进度已接近完工阶段，计划于 2024 年上半年实现投产，并陆续开展客户验证、产品放量阶段。

华正新材：公司半导体封装材料包括 BT 封装材料和 CBF 积层绝缘膜，适用于 Chiplet、FC-BGA 等先进封装工艺，主要应用于 Memory、MEMS、RF、ECP 嵌埋技术及 CPU、GPU、FPGA、ASIC 等算力芯片的半导体封装。公司半导体封装材料已形成系列产品，部分产品已进入小批量订单交付阶段。公司目前与华为的合作覆盖 FR4、高频、高速、导热、半导体封装等材料；主要应用于基站、无线、数通、车载、服务器、光伏能源、半导体等领域。

德邦科技：公司应用于半导体行业的产品主要包括：1、UV 膜系列，包括减薄膜和切割膜。应用于晶圆的减薄和切割工艺，目前已经稳定批量出货；2、固晶系列，包括固晶胶和固晶膜(DAF/CDAF)。其中固晶胶主要应用于芯片固定粘接，目前已经稳定批量出货;固晶膜主要应用于多层芯片的堆叠以及替代固晶胶，2023 年下半年开始在客户端推进验证、导入，目前已在多个客户实现小批量出货，实现了进口替代。3、导热系列，目前出货的产品包括 Tim1.5、Tim2 等系列导热材料，主要应用于手机、服务器等领域，已经稳定批量出货;芯片级导热界面材料(Tim1)

目前仍处于验证导入阶段。4、AD 胶、芯片级底填（Underfill1）等先进封装材料目前同时在配合多家设计公司、封测厂推进验证，并已通过头部客户验证，其中 AD 胶已小批量出货，实现了进口替代。

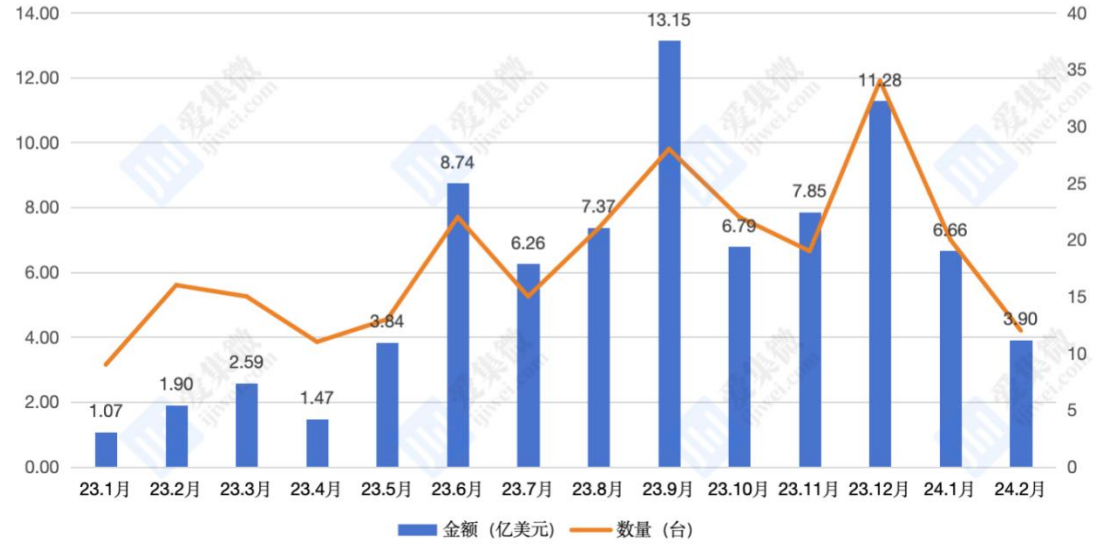
华海诚科：公司主要产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景。在先进封装领域，公司研发了应用于 QFN、BGA、FC、SiP 以及 FOWLP/FOPLP 等封装形式的封装材料，其中应用于 QFN 的产品已实现小批量生产与销售，颗粒状环氧塑封料（GMC）以及 FC 底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证，液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中，上述应用于先进封装的产品有望逐步实现产业化并打破外资厂商的垄断地位。

1.5 荷兰首相拟访华，ASML 光刻机供应持续高增

3 月 23 日，路透社报道，荷兰首相马克吕特将于下周会见习近平主席，双方将就 ASML 数十亿欧元光刻机订单的供应许可展开洽谈。

ASML 作为全球龙头光刻机供应商，2023 年在中国大陆地区收入高达 72.52 亿欧元，同比增长 149%，占其总营收 26%。2024 年以来，伴随中国大陆半导体投资持续高增，ASML 光刻机出货亦持续增长。据中国海关总署数据，**2024 年 1 月-2 月，从荷兰进口光刻机 10.57 亿美元，同比增长 256.1%**，进口数量达 32 台，进口均价亦大幅增长，从 2023 年初的 1000 万美元/台增长至 2024 年以来超过 3000 万美元/台。

图 14：2023 年-2024 年 2 月荷兰光刻机进口金额和数量



资料来源：中国海关总署，集微咨询，民生证券研究院

前期，ASML 亦在 23Q4 法说会上表达对 2024 年中国市场需求的乐观展望，ASML 表示 2024 年中国市场中等先进制程（mid-critical nodes）和成熟制程光

刻机需求仍持续强劲。

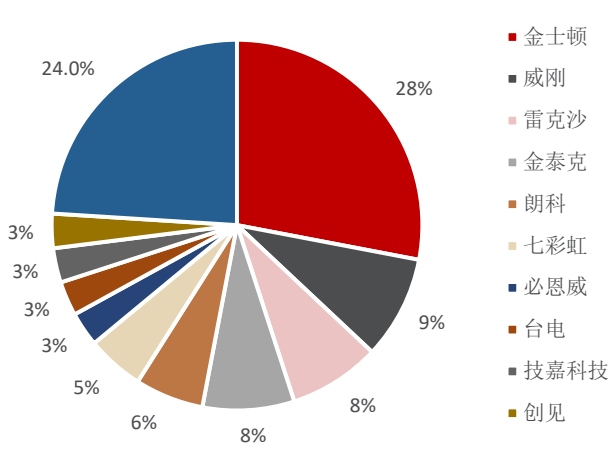
光刻机供给持续高增，亦将有助国内晶圆厂建设投资的持续增长。我们看好扩产加速之下的设备板块投资机遇。

1.6 翔港科技投资金泰克，涉足存储市场

3 月 21 日，翔港科技公告，公司计划以自有或自筹资金 1.5 亿元认购深圳市金泰克半导体有限公司，本次交易完成后，公司持有金泰克 10%股权，金泰克成为公司的参股公司。

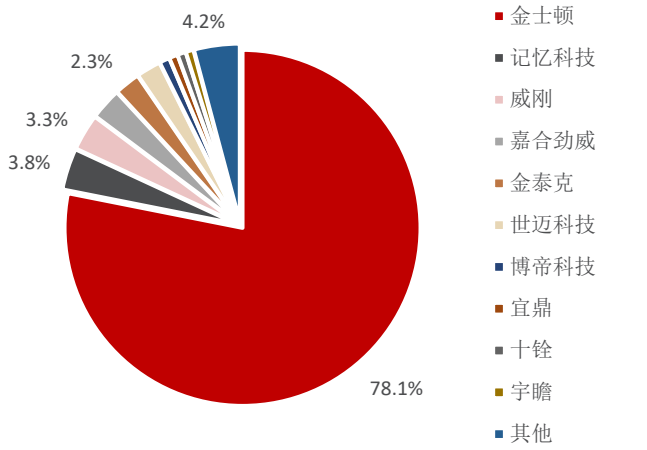
标的公司情况：金泰克成立于 2012 年，是一家集研发、生产和自主品牌产品营销于一体的专业存储方案提供商，主要提供内存、SSD 相关存储产品，产品涵盖消费级、工业控制级、企业级和嵌入式存储，能够为客户提供完整的存储产品解决方案。目前金泰克企业级内存产品已实现了批量出货，在国内同行业公司中具有一定领先优势。根据 Trendforce 数据显示，2022 年全球前十大 SSD 模组自有品牌于 SSD 通路市场（不含原厂）出货排名中，金泰克排名第四，市占率约 8%；2022 年内存模组出货排名中，金泰克排名第五，市占率 2.33%。

图 15：2022 年模组厂 SSD 收入排名



资料来源：Trendforce，民生证券研究院

图 16：2022 年模组厂 DRAM 内存条收入排名



资料来源：Trendforce，民生证券研究院

2023 年金泰克实现营收 9.41 亿元，净利润-3.51 亿元，2024 年 1-2 月（未经审计），金泰克实现营收 7.79 亿元，净利润 0.57 亿元。

表1：金泰克最近一年及一期主要财务指标（万元）

项目	2023 年/2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 1-2 月/2024 年 2 月 29 日（未经审计）
营业收入	94,067.79	77,864.70
营业利润	-35,082.03	5,715.11
净利润	-35,076.73	5,712.02
总资产	130,457.98	149,091.41

所有者权益	-66,683.89	-61,183.73

资料来源：Wind，民生证券研究院

我们认为，受益存储涨价，金泰克有望迎来大幅业绩释放。且长期看，随着 AI 驱动数据中心建设加速，存储容量和处理能力的需求也随之增加。而翔港科技通过此次投资，为此后深入涉足存储市场提供经验，有助于翔港科技业务领域拓展，提升综合竞争力。

2 公司新闻

崇达技术：3 月 17 日消息，为契合公司业务长期发展需求，推进海外布局战略，满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力，公司拟围绕主业，面向东南亚地区项目开展境外投资事项，本次投资总额不超过 5 亿元人民币或等值币种。

联合光电：3 月 17 日消息，公司发布 2024 年员工持股计划（草案），拟向包含董事、监事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员等在内的不超过 80 人，本员工持股计划受让的股份总数不超过 279.34 万股，占公司目前总股本的 1.04%，受让价格为 8.75 元/股。

帝科股份：3 月 18 日消息，富海新材、富海二期计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后 3 个月内以集中竞价交易方式合计减持公司股份数量不超过 1,005,000 股，即不超过公司总股本的 1.00%。二者截至本公告日合计持有公司股份 5,447,499 股，占帝科股份总股本的比例为 5.4204%。

芯源微：3 月 18 日消息，公司拟于 2024 年 3 月 19 日在公司上海临港厂区竣工仪式现场发布前道单片式化学清洗机新品 KS-CM300，于 3 月 20 日至 22 日 SEMICON China 2024 上海国际半导体展会期间发布全自动 SiC 划片裂片一体机新品 KS-S200-2S1B。

合力泰：3 月 18 日消息，自 2024 年 1 月 18 日至本公告披露日期间，公司及合并报表范围内公司累计新增诉讼、仲裁的涉案金额合计为 136,677.27 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 24.92%。

金海通：3 月 18 日消息，公司发布 2024 年员工持股计划（草案），参与对象包含董事、监事、高级管理人员及骨干人员等在内的不超过 109 人，本员工持股计划受让的规模不超过 68.92 万股，占公司当前总股本的 1.15%，受让价格为 36.52 元/股。

中微公司：3 月 18 日消息，公司发布 2024 年年报，2023 年，公司新签订单 83.6 亿元，同比增长 32.3%，实现营业收入 62.64 亿元，同比增长 32.15%，实现归母净利润 17.86 亿元，同比增长 52.67%。

长盈精密：3 月 18 日消息，公司发布 2023 年年报，2023 年，公司实现营业收入 137.22 亿元，同比-9.74%，实现归母净利润 0.86 亿元，同比增长 102.23%。

铜峰电子：3 月 18 日消息，公司发布 2023 年年报，2023 年，公司实现营业收入 10.83 亿元，同比增长 4.11%，实现归母净利润 0.87 亿元，同比增长 17.30%。

金百泽：3 月 19 消息，公司股东张伟先生持有公司股份 9,242,000 股，占公司总股本的 8.6633%，拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式，减持公司股份不超过 3,200,400 股（其中大宗交易不超过 2,133,600 股，集中竞价交易不超过

1,066,800 股），即不超过公司总股本的 3%。

韦尔股份：3 月 19 日消息，公司控股股东一致行动人绍兴韦豪计划向宁波东方理工大学教育基金会无偿捐赠其持有公司的 15,000,000 股无限售条件流通股，占公司目前总股本的 1.23%。截至本公告披露日，公司控股股东一致行动人绍兴韦豪持有公司股份 89,132,662 股，占公司目前总股本的 7.33%。

长光华芯：3 月 19 日消息，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 63.59 元/股（含）。

纳芯微：3 月 19 日消息，公司部分董事、高级管理人员及核心人员基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟自 2024 年 3 月 20 日起 3 个月内增持公司股份，本次合计增持金额不低于人民币 1,400 万元（含），且不超过人民币 2,100 万元（含）。

显盈科技：3 月 19 日消息，公司拟向不特定对象发行可转债，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 37,000.00 万元（含 37,000.00 万元）。

长电科技：3 月 19 日消息，因公司大股东大基金、芯电半导体正在筹划公司股权转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，本公司的相关证券停复牌。

南芯科技：3 月 19 日消息，公司发布 2023 年年报，2023 年，公司实现营业收入 17.8 亿元，同比增长 36.87%，实现归母净利润 2.61 亿元，同比增长 6.15%。

腾景科技：3 月 20 日消息，公司发布 2023 年年报，2023 年，公司实现营业收入 3.4 亿元，同比-1.29%，实现归母净利润 0.42 亿元，同比-28.72%。

唯特偶：3 月 20 日消息，公司发布 2024 年股权激励计划（草案），拟授予激励对象的股票期权数量为 173.75 万份，占公司总股本 2.96%，首次授予激励对象共计 364 人，首次授予股票期权的行权价格为 50 元/份。

木林森：3 月 20 日消息，公司于近日收到股东济南汇盛投资合伙企业有限合伙）出具的关于提前终止减持计划的告知函》，截至公告之日，济南汇盛投资合伙企业有限合伙）减持 2,763,400 股股份，合计减持比例 0.19%，决定提前终止本次股份减持计划。

水晶光电：3 月 21 日消息，公司发布 2023 年年报，2023 年，公司实现营业收入 50.76 亿元，同比增长 16.01%，实现归母净利润 6 亿元，同比增长 4.15%。

新洁能：3 月 21 日消息，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民 3,500 万元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），回购价格不超过人民币 50 元/股（含）。

盈方微：3 月 21 日消息，持股 5%以上股东东方证券计划在本公告披露之日

起十五个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上限不超过公司总股本的 3%。

伟测科技：3 月 21 日消息，公司发布 2023 年年报，2023 年，公司实现营业收入 7.37 亿元，同比增长 0.48%，实现归母净利润 1.18 亿元，同比-51.57%。

必易微：3 月 22 日消息，公司发布 2023 年年报，2023 年，公司实现营业收入 5.78 亿元，同比增长 10.01%，实现归母净利润-0.19 亿元，同比转亏。

博敏电子：3 月 22 日消息，公司发布 2024 年员工持股计划（草案），参与对象包含董事、监事、高级管理人员及其他核心人员等在内的不超过 80 人，本员工持股计划的股票来源为公司回购股份 13,690,300 股，占公司当前总股本的 2.15%，受让价格为 4.80 元/股。

法拉电子：3 月 22 日消息，公司发布 2023 年年报，2023 年，公司实现营业收入 38.8 亿元，同比增长 1.14%，实现归母净利润 10.24 亿元，同比增长 1.72%。

炬光科技：3 月 22 日消息，公司股东张彤因个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持 802,997 股股份，占公司总股本的 0.8886%。截至本公告披露之日，张彤持有公司 802,997 股，占公司总股本的 0.8886%。

石英股份：3 月 22 日消息，公司发布 2023 年年报，2023 年，公司实现营业收入 71.84 亿元，同比增长 258.46%，实现归母净利润 50.39 亿元，同比增长 378.92%。

钜泉科技：3 月 22 日消息，公司发布 2023 年年报，2023 年，公司实现营业收入 6.03 亿元，同比-15.05%，实现归母净利润 1.31 亿元，同比-34.3%。

复旦微电：3 月 22 日消息，公司发布 2023 年年报，2023 年，公司实现营业收入 35.36 亿元，同比-0.07%，实现归母净利润 7.19 亿元，同比-33.18%。

赛微电子：3 月 22 日消息，公司拟向不特定对象发行可转债不超过 19,743,210 张（含本数），本次可转债发行总额不超过人民币 197,432.10 万元（含 197,432.10 万元）。

华岭股份：3 月 22 日消息，公司发布 2023 年年报，2023 年，公司实现营业收入 3.15 亿元，同比增长 14.52%，实现归母净利润 0.75 亿元，同比增长 7.15%。

纬达光电：3 月 22 日消息，公司发布 2023 年年报，2023 年，公司实现营业收入 2.03 亿元，同比-23.96%，实现归母净利润 0.32 亿元，同比-50.59%。

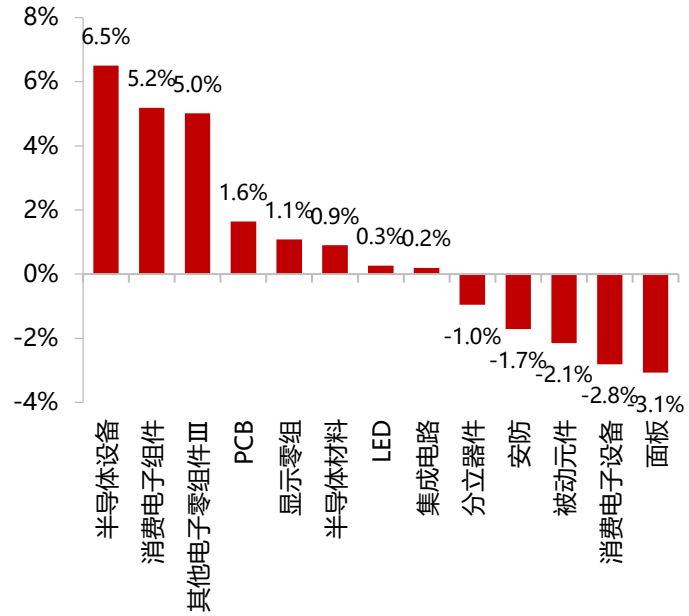
乐鑫科技：3 月 22 日消息，公司发布 2023 年年报，2023 年，公司实现营业收入 14.33 亿元，同比增长 12.74%，实现归母净利润 1.36 亿元，同比增长 39.95%。

3 市场行情回顾

最近一周（3 月 18 日-3 月 22 日）电子板块涨跌幅为 1.48%，相对沪深 300 指数涨跌幅+2.18pct。年初至今电子板块-6.31%，相对沪深 300 指数涨跌幅-9.63pct。

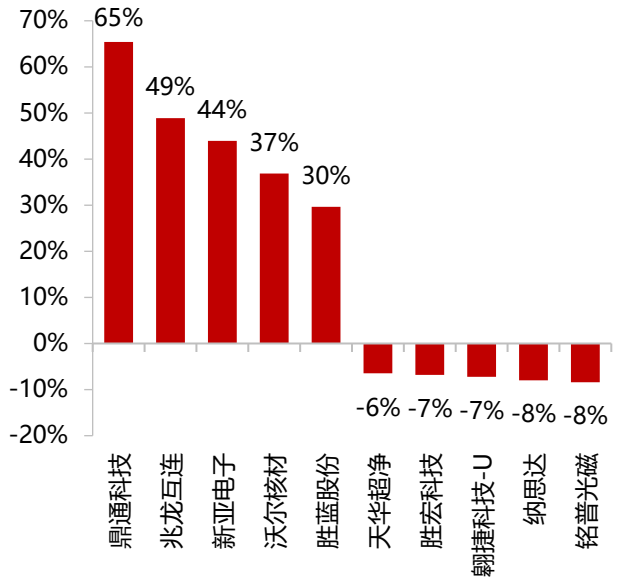
本周电子行业子板块涨跌幅分别为半导体设备 6.51%，消费电子组件 5.18%，其他电子零组件Ⅲ 5.01%，PCB 1.64%，显示零组 1.08%，半导体材料 0.90%，LED 0.27%，集成电路 0.19%，分立器件-0.95%，安防-1.71%，被动元件-2.15%，消费电子设备-2.81%，面板-3.07%。

图 17：电子行业子板块周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，民生证券研究院

图 18：电子行业个股周涨幅前五&跌幅前五（%）



资料来源：Wind，民生证券研究院

表2：电子行业重点关注个股

证券代码	证券简称	股价（元）	周涨跌幅（%）	EPS（元）			PE			PB-MRQ	评级
				2022A	2023E	2024E	2022A	2023E	2024E		
002463.SZ	沪电股份	31.84	1.40	0.71	0.79	1.23	45	40	26	6.7	推荐
300476.SZ	胜宏科技	25.40	-6.79	0.92	1.01	1.41	28	25	18	3.0	/
002436.SZ	兴森科技	13.58	-2.37	0.33	0.14	0.24	41	97	57	3.4	推荐
002156.SZ	通富微电	24.80	-2.75	0.37	0.12	0.68	67	207	36	2.7	推荐
603283.SH	赛腾股份	83.05	-3.27	1.66	3.31	3.97	50	25	21	8.6	/
688627.SH	精智达	77.00	2.95	0.94	1.25	1.68	82	62	46	4.4	谨慎推荐
0522.HK	ASMPT	99.85	0.15	6.33	1.73	3.36	16	58	30	2.6	/
002130.SZ	沃尔核材	9.99	36.85	0.49	0.56	0.69	20	18	14	2.6	/
601137.SH	博威合金	21.05	34.08	0.68	1.37	1.64	31	15	13	2.5	/
688668.SH	鼎通科技	71.98	65.40	1.95	1.04	2.43	37	69	30	4.2	/
002475.SZ	立讯精密	31.84	14.66	1.29	1.57	2.03	25	20	16	4.4	推荐
6088.HK	鸿腾精密	0.26	25.00	0.02	0.02	0.03	13	13	9	0.8	/
605277.SH	新亚电子	20.80	43.94	0.77	-	-	27	-	-	4.2	/
688629.SH	华丰科技	33.69	45.53	0.25	0.17	0.34	135	194	100	10.6	/
0992.HK	联想集团	1.24	2.42	0.13	0.07	0.10	10	18	12	4.9	推荐
1810.HK	小米集团	13.62	1.79	0.10	0.70	0.57	136	19	24	2.0	推荐
001309.SZ	德明利	130.00	28.59	0.96	0.22	3.72	135	591	35	13.1	推荐
301308.SZ	江波龙	96.69	7.31	0.19	-1.70	1.11	509	/	87	6.7	/
688123.SH	聚辰股份	58.62	4.07	2.93	0.63	1.89	20	93	31	4.8	推荐
002409.SZ	雅克科技	58.70	7.81	1.10	1.32	1.89	53	44	31	4.1	推荐
688268.SH	华特气体	51.01	0.95	1.71	1.37	1.87	30	37	27	3.8	推荐
002371.SZ	北方华创	312.51	8.12	4.46	7.26	10.19	70	43	31	7.3	推荐
688012.SH	中微公司	158.81	5.47	1.89	2.88	3.30	84	55	48	5.5	推荐
688037.SH	芯源微	119.57	3.53	2.27	2.22	3.04	53	54	39	7.1	推荐
002859.SZ	洁美科技	22.63	-3.21	0.38	0.58	0.83	60	39	27	3.5	推荐

资料来源：iFinD，民生证券研究院；

（注：股价为 2024 年 3 月 22 日收盘价，PB 为 MRQ 为 23Q3 数据；胜宏科技、赛腾股份、ASMPT、沃尔核材、博威合金、鼎通科技、鸿腾精密、新亚电子、华丰科技、江波龙等未覆盖公司采用 iFind 一致预期；鸿腾精密、联想集团股价根据 3 月 22 日美元兑港元汇率 7.8 换算为美元，EPS 单位也为美元；ASMPT 股价和 EPS 均为港元；ASMPT、鸿腾精密、小米集团、德明利、中微公司 2023 年为实际数据）

4 风险提示

1）电子行业周期复苏不及预期：电子行业具有周期性特征，若行业景气度复苏不及预期，将对板块公司业绩造成不利影响；

2）行业竞争加剧：国内诸多厂商布局了人工智能及先进封装技术，若行业竞争加剧，将对板块公司业绩造成不利影响；

3）汇率波动：电子板块部分公司海外业务占比较高，汇率波动将影响公司业绩。

插图目录

图 1：GB200 芯片参数 3
图 2：英伟达新一代 NV Switch 芯片参数 3
图 3：GB200 NVL72 compute Rack 架构 4
图 4：GB200 数据中心架构 4
图 5：与 H100 相比，GB200 可以提供 30 倍的实时吞吐量 4
图 6：GB200NVL72 架构 5
图 7：AMD 针对 AI 不同应用场景布局的几类架构 8
图 8：AMD 强调 AI PC 生态 9
图 9：AMD 与联想共同打造 AI PC 9
图 10：Surface Pro 10 商用版 10
图 11：Surface Laptop6 商用版（红框为 Copilot 键） 10
图 12：Copilot 生成邮件回复 10
图 13：Copilot 帮助清理存储空间 10
图 14：2023 年-2024 年 2 月荷兰光刻机进口金额和数量 15
图 15：2022 年模组厂 SSD 收入排名 16
图 16：2022 年模组厂 DRAM 内存条收入排名 16
图 17：电子行业子板块周涨跌幅（%） 21
图 18：电子行业个股周涨幅前五&跌幅前五（%） 21

表格目录

表 1： 金泰克最近一年及一期主要财务指标（万元） 16
表 2： 电子行业重点关注个股 22

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

评级说明

投资建议评级标准	评级		说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	公司评级	推荐	相对基准指数涨幅 15%以上
		谨慎推荐	相对基准指数涨幅 5%～15%之间
		中性	相对基准指数涨幅-5%～5%之间
		回避	相对基准指数跌幅 5%以上
	行业评级	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
		中性	相对基准指数涨幅-5%～5%之间
		回避	相对基准指数跌幅 5%以上

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F； 200120

北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层； 100005

深圳：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 层 05 单元； 518026